

BSC/25-40

Ferramenta para remoção de semicondutora não pelável.

A ferramenta BSC/25-40 permite a remoção da semicondutora não pelável, obtendo um chanfro e um acabamento superficial de muito boa qualidade.

A ferramenta requer a utilização de silicone.



Especificações Técnicas:

Embalagem: Caixa de cartão
Comprimento (mm): 155
Largura (mm): 82
Altura (mm): 65
Diâmetro máximo (mm): 44
Diâmetro mínimo (mm): 14
Profundidade de corte máx. (mm): 1,5
Ângulo do chanfro (°): 14,5
Comprimento restante do semicondutor (mín.) (mm): 25

Peças de substituição:

Lamina de substituição ASCR1

